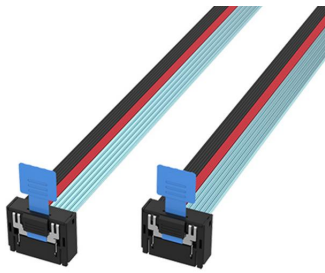


Cablexa CAB-RAGZ1C-RAGZ1C Datenblatt



Gen-Z 1C 56P R/A auf Gen-Z 1C 56P R/A EDSFF-Kabel

CAB-RAGZ1C-RAGZ1C

Gen-Z 1C 56P R/A auf Gen-Z 1C 56P R/A EDSFF-Kabel

Das Gen-Z 1C 56P R/A auf Gen-Z 1C 56P R/A EDSFF-Kabel ist ein leistungsstarkes externes Kabel für Rechenzentren und Enterprise-Speicherumgebungen der nächsten Generation. Dieses Kabel bietet eine zuverlässige rechtwinklige (R/A)-zu-rechtwinklige (R/A) Verbindung zwischen Geräten mit Gen-Z 1C 56-Pin-Schnittstellen, speziell zugeschnitten auf EDSFF-Anwendungen (Enterprise and Data Center SSD Form Factor). Diese Lösung wurde für die Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsprotokollen und Stromversorgung entwickelt und ermöglicht eine effiziente Konnektivität zwischen Gen-Z-basierten Hosts und EDSFF-Speichergeräten bei gleichzeitiger Optimierung der Platznutzung und Signalintegrität in anspruchsvollen Speicherkonfigurationen.

Merkmale

- Rechtwinkliges Steckerdesign: Verfügt über rechtwinklige Stecker an beiden Enden, was eine effiziente Kabelführung ermöglicht und Behinderungen in Server- und Speicherumgebungen mit hoher Dichte, insbesondere bei platzbeschränkten EDSFF-Formfaktoren, minimiert.
- Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsdaten: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 56 GT/s (PAM4) oder 32 GT/s (NRZ), entspricht den Spezifikationen von Gen-Z und PCIe 5.0/6.0 und gewährleistet die Kompatibilität mit Anwendungen mit hoher Bandbreite wie All-Flash-Arrays und Computerspeicher.
- Verbesserte Signalintegrität: Verwendet präzisionsgefertigte Kabel (z. B. Twinaxial- oder aktive optische Kabel) mit mehrschichtiger Abschirmung, um Einfügungsverluste, Übersprechen und elektromagnetische Störungen (EMI) zu minimieren und so eine stabile Datenübertragung bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.

- Strom- und Datenintegration: Kombiniert Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen mit Stromversorgungsfunktionen im selben Anschluss und unterstützt gemäß den Gen-Z 1C-Spezifikationen bis zu 80 W Leistung (12 V Haupt- und 3,3 V Zusatzstrom), sodass keine separaten Stromkabel erforderlich sind.
- EDSFF-Optimierung: Speziell für EDSFF-Formfaktoren (z. B. E1.S, E1.L, E3.S) entwickelt und bietet mechanische und elektrische Kompatibilität mit neuen SSD-Standards in Rechenzentren und Hyperscale-Umgebungen.
- Robuste Konstruktion: Verfügt über langlebige Anschlüsse mit Metallgehäusen und sicheren Verriegelungsmechanismen, um zuverlässige Verbindungen in vibrationsanfälligen Umgebungen zu gewährleisten, sowie über Betriebstemperaturbereiche, die für Rechenzentrumsbedingungen geeignet sind (z. B. 0 °C bis +70 °C).

Technische Daten

- Produktmodell: Gen-Z 1C 56P R/A auf Gen-Z 1C 56P R/A EDSFF-Kabel
- Anschluss A: Gen-Z 1C, 56-Positionen, Stecker, rechtwinklig
- Anschluss B: Gen-Z 1C, 56-Positionen, Stecker, rechtwinklig
- Steckergeschlecht: Männlich auf Männlich
- Kabeltyp: Externes aktives optisches Kabel (AOC) oder passives Kupferkabel
- Kabellänge: Standardoptionen: 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m (Sonderlängen bis zu 10 m für AOC-Varianten)
- Unterstützte Datenrate: Bis zu 56 GT/s (PAM4), 32 GT/s (NRZ)
- Unterstützte Protokolle: Gen-Z, PCI Express (PCIe) 5.0/6.0, NVMe over Fabrics (NVMe-oF)
- Stromversorgung: Bis zu 80 W (12 V Haupt- + 3,3 V Zusatzstrom)
- Impedanz: 85 Ohm (differentiell)
- Abschirmung: Folien- und Geflechtabschirmung zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C (kommerziell); -40 °C bis +85 °C (industrielle Optionen)
- Haltbarkeit: Mindestens 1.000 Steckzyklen

Anwendungen

- EDSFF-Speicher-Arrays: Verbinden Sie Gen-Z-Hosts oder -Switches mit EDSFF-SSDs in All-Flash-Speicher-Arrays und ermöglichen Sie so Hochgeschwindigkeitsdatenzugriff und Skalierbarkeit in Rechenzentren.
- High-Performance Computing (HPC): Unterstützung von HPC-Clustern und KI-Trainingsservern, die Verbindungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite zwischen Rechenknoten und Gen-Z-basierten Speichersystemen erfordern.
- Rechenzentrumsinfrastruktur: Bereitstellung in Hyperscale-Rechenzentren für flexible

Speicherlösungen, die die speicherzentrierte Architektur der Generation Z für eine effiziente Ressourcenzusammenstellung nutzen.

- Cloud- und Edge-Speicher: Erleichtert Speichererweiterungen in Cloud- und Edge-Umgebungen, in denen EDSFF-Formfaktoren und rechtwinklige Anschlüsse den Platzbedarf und das Wärmemanagement optimieren.
- Systemintegration und Upgrades: Ermöglicht die nahtlose Integration von Gen-Z-fähigen Speichergeräten in die vorhandene Infrastruktur, insbesondere bei Upgrades auf PCIe 5.0/6.0- oder NVMe-oF-Plattformen.
- OEM- und Serverherstellung: Wird von Server-OEMs verwendet, um kompakte Speicherlösungen mit hoher Dichte zu entwickeln, die den EDSFF-Standards entsprechen und gleichzeitig den Kabelsalat minimieren und die Luftzirkulation verbessern.

[Jetzt kaufen](#)